

# 財團法人工業技術研究院

## 電子、光電與顯示等相關技術暨專利非專屬授權案

- 一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）
- 二、非專屬授權標的：電光領域相關技術(26 件，以下稱：技術授權標的)，與專利(117 案 173 件，以下稱：專利授權標的)，專利共分為十四個類別：(一)透明顯示系統平台技術(21 案 27 件)、(二)面板級扇外型封裝技術(17 案 25 件)、(三)OLED 照明(7 案 7 件)、(四)功率裝置/模組(3 案 5 件)、(五)系統級構裝技術(SiP)(4 案 13 件)、(六)半導體光源(12 案 15 件)、(七)光電半導體技術(4 案 6 件)、(八)記憶體(6 案 9 件)、(九)感測器(7 案 10 件)、(十)電路載板(10 案 23 件)、(十一)寬能隙元件(4 案 4 件)、(十二)影像技術(6 案 8 件)、(十三)軟體(6 案 11 件)及(十四)其他(10 案 10 件)。其中第 1~4、6~19、22~26、31~38、49~51、102~105 案為共有專利。

詳如下述網站：

- (一) 工研院研發成果公告網：

<https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1>

- (二) 台灣技術交易資訊網(TWTM)：

<https://www.twtm.com.tw/Web/index.aspx>

- 三、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

- 四、公開說明會：

### 第一場 公開說明會

- (一) 舉辦時間：民國（下同）108 年 8 月 29 日下午 14 時至 17 時。
- (二) 舉辦地點：2019 智慧顯示展覽會—台北南港展覽館 1 館 4F/J412（台北市南港區經貿二路 1 號）。
- (三) 無須報名：於說明會時段逕至展區參與，並於展場簽名、惠賜名片。

### 第二場 公開說明會

- (一) 舉辦時間：民國（下同）108 年 9 月 2 日下午 15 時至 16 時。
- (二) 舉辦地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110-1 室。

(三) 報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名此場者，請於 108 年 8 月 26 日中午 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「電子、光電與顯示等相關技術暨專利非專屬授權案：公開說明會報名」，並於內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）。

五、聯絡人：工研院技術移轉與法律中心 林小姐

電話：+886-3-591-6636

傳真：+886-3-582-0466

電子信箱：iris.lin@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

附件：

### 一、技術授權標的 (26 件)

件次	產出年度	中文名稱	技術特色	可應用範圍	計畫名稱
1	107	高透明 AMOLED 顯示器技術	高機械強度且耐彎曲之硬質塗層技術，鉛筆硬度達 8H 且通過 r=3mm/200K 次摺疊測試。	穿戴式裝置、智慧行動裝置、智慧手持裝置	先進透明顯示系統與應用技術暨服務開發計畫
2	104	耐高溫軟性阻氣基板與離型層技術	高溫軟性基板經過不同溫度或條件之製程後，探討機械取下離型力之變化，供後續軟性元件進行機械取之參數調整之參考。	Flexible AMOLED、OLED 照明，軟性電子元件，Flexible LCD、Flexible micro LED	智慧手持裝置核心技術攻堅計畫
3	106	軟性 OLED 封裝技術	以單層 PECVD 阻氣製程技術整合側向阻氣結構(SWB)，完成側向阻氣封裝蓋板，搭配低釋氣之軟性膠材對 OLED 進性軟性封裝，並探討該封裝技術對 OLED 之可靠度。	Rigid or Flexible AMOLED、OLED 照明，軟性電子元件	智慧手持裝置核心技術攻堅計畫
4	103	耐高溫阻氣軟性基板與離型技術	利用側向阻氣結構開發 SWB(Side Wall Barrier)進行 TE OLED 元件封裝測試。	Rigid or Flexible AMOLED、OLED 照明，軟性電子元件	智慧手持裝置核心技術攻堅計畫
5	102	耐高溫阻氣軟性基板技術	本技術之設計與整合離型層、塗佈型軟性基板於玻璃載板上，相容於現行片對片傳送(Sheet to sheet, S2S)之設備與製程	Rigid or Flexible AMOLED、OLED	先進互動與 3D 顯示系統技術關鍵計畫

件次	產出年度	中文名稱	技術特色	可應用範圍	計畫名稱
			(例如 TFT-LCD)，具備耐高溫( $\geq 220^{\circ}\text{C}$ )、高重覆對位精度( $\leq 2\mu\text{m}$ )等優點，在搭配離型取下關鍵模組技術即可完成軟性元件製作。	照明，軟性電子元件	
6	100	高阻氣性基板製程技術	建立軟性基板製程標準並持續提昇取下良率，開發多邊形之基板製程技術，同時研發具可撓性的阻水氣層技術與軟性基板整合之製程技術。並建立相關可撓性 Gas Barrier 的評估機制，此一關鍵基礎技術，將可協助廠商建立關鍵性高阻氣軟性基板技術之研發及量測平台，對於開發軟性 AMOLED 顯示器將具有決定性的幫助及影響。	Rigid or Flexible AMOLED、OLED 照明，軟性電子元件	新世代捲軸軟性顯示關鍵技術發展計畫
7	99	顯示互動元件與驅動技術	利用網印製程技術評估不同的 Side Wall Barrier 材料與製程。	Rigid or Flexible AMOLED、OLED 照明，軟性電子元件	新世代捲軸軟性顯示關鍵技術發展計畫
8	106	智慧健康管理平台 人工智慧技術	多維度職場壓力評估系統以先期驗證為主，乃是結合生理訊號擷取與行動認知量表及系統整合，透過人工智慧機器學習演算法的導入而增加其應用範圍及價值，此階段參與人員將優先考量高壓力職場環境，如醫療院所員工及高科技從事人員等累計 30 人次、且工作時數須達 8 小時進行資料收集，再進行複合式機器學習生理訊號判讀，數據分析結果亦可串接至業者雲端醫療系統，進一步整合入服務模式平台。	智慧健康平台、人工智慧分析技術。	工研院創新前瞻技術研究計畫
9	106	智能減碳卷對卷製造系統	智能減碳卷對卷製造系統 SAMMCERS 以達到智慧產線為目的，當製程即將超出參數所設定的最佳值，會立即偵測製程，同時預測是否會有不良品出現，進而修正參數、導正系統。	觸控面板、OLED lighting、太陽能、PCB 產業。	智慧手持裝置核心技術攻堅計畫
10	106	超精細金屬導線觸控面板製程	「非黃光之創新卷對卷製程」，將超細導線印刷技術(fine line printing)導入金屬網格(metal mesh)製程，用以取代傳統 ITO 製成之觸控面板，此舉兼具成本競爭力與環保優勢。以創新設計之卷對卷(R2R)設備與傳輸技術，整合 $1. < 100\mu\text{m}$	觸控面板、OLED lighting、顯示器。	智慧手持裝置核心技術攻堅計畫

件次	產出年度	中文名稱	技術特色	可應用範圍	計畫名稱
			厚度之超薄基板、2. 印製 20 $\mu$ m/20 $\mu$ m 線寬/線距之超窄邊框與 3. <5 $\mu$ m 之金屬網格導電層設計，三大特點將可提供業者發展可量產並具備成本優勢之產品。		
11	107	高階阻水組氣膜技術開發	目前大多高階阻水組氣膜皆以 homemade 為主，對外販售的廠商極少且價格高昂。工研院透入自製設備及技術開發可達到 WVTR (g/m <sup>2</sup> *day)=10-5，可協助台灣廠商進行產品升級。	軟性電子產業，如觸控面板、軟性顯示器、OLED 照明、軟性太陽能電池等。	工研院創新前瞻技術研究計畫
12	107	智能排程演算法評估	本評估報告將整合運用設備製程特有的領域知識，結合各式最佳化數學規劃方法，以期未來可引伸至網頁視覺化動態排程系統，解決本國產業長久以來的高速動態排程問題，增進生產力，邁向生產工業 4.0。	各式需要排程之產業	工研院創新前瞻技術研究計畫
13	107	OLED 照明驅動模組技術開發	1. 藉由電壓偵測單一 OLED 短路、開路失效的控制系統 2. 輸入小信號電源流，得到較大的電壓差異，方便設定電壓偵測之最小值，作為短路偵測。	1.博物館、展示館、高級設計桌燈 2.商場照明、汽車照明(尾燈與內裝)、具規模客製化照明(如豪宅) 3.一般居家照明。	建置 OLED 照明量產核心技術計畫
14	107	一種可解決生產方向對位精度問題之 OLED 生產製程	在卷對卷 OLED 照明的製程中，一般須同時考量 MD 與 TD 方向之對位，對於連續式動態傳輸系統的檢測與調整負擔過大，易造成鍍膜不均，故本技術結合 OLED 照明製程中原有蒸鍍或濺鍍製程均則需搭配鍍膜遮罩，藉由鍍膜遮罩的設計，同時解決 TD 方向對位與鍍膜之問題，為卷對卷 OLED 照明關鍵技術。	1.博物館、展示館、高級設計桌燈 2.商場照明、汽車照明(尾燈與內裝)、具規模客製化照明(如豪宅) 3.一般居家照明。	建置 OLED 照明量產核心技術計畫
15	107	超薄可撓玻璃 R2R 生產傳輸系統	軟性面板產品逐漸步上商業化軌道，軟性面板製程的核心技術需搭配材料、設備與製程相輔相成。工研院開發革新製程的 Roll-to-Roll (R2R) 輕量化生產技術，符合超薄可撓基板的輕、薄、大面積、節能環保製造需求，建立超薄可撓玻璃 R2R 生產傳輸系統，提供產業完整解決方案。	軟性電子產業，如觸控面板、軟性顯示器、OLED 照明、軟性太陽能電池等。	建置 OLED 照明量產核心技術計畫

件次	產出年度	中文名稱	技術特色	可應用範圍	計畫名稱
16	107	蒸鍍源開發	OLED 照明及太陽能產業皆有蒸鍍設備需求，鑑於蒸鍍源目前皆為國外製造價格昂貴使台灣廠商開發卻步，工研院開發蒸鍍源國產化，方能降低價格，掌握整線設計。	OLED 照明、太陽能。	建置 OLED 照明量產核心技術計畫
17	107	穿戴式嬰兒生理監控系統	穿戴式嬰兒生理監控系統，可即時量測嬰兒呼吸及心率，並將量測的結果回傳至系統，家長及醫護人員可透過電子告示板或手機等行動裝置即時得知嬰幼兒目前的生理狀況，當生理資訊出現狀況時，系統也將發出警報，提醒家長及醫護人員前往察看，未來將可運用於居家照護、醫院嬰兒室、月子中心、托嬰中心等。	居家照護、醫院嬰兒室、月子中心、托嬰中心等。	工研院創新前瞻技術研究計畫
18	108	動作感知技術	利用 3D 相機及 IMU 融合運算，達到頭戴式(inside-out)動作追蹤。並建立肢體機器學習模型，以預測及辨識動作變化。	全身動作感測可運用於 VR/AR/MR 應用	次世代環境智能系統技術研發與應用推動計畫
19	108	即時環境掃描與建模技術	可計算拍攝路徑，整合高密度點群空間模型，並具備偵測迴路與累計誤差補正能力。	人工智慧視覺高精度 3D 深度相機所需要之校正與檢測平台，以 AR/VR 裝置為主要應用載具，提供硬體平台及軟體套件，協助 3D 深度相機產業產線建立及生產效能的提升。	次世代環境智能系統技術研發與應用推動計畫
20	108	超高頻系統實驗室-縮距場天線室測試技術	此天線量測技術提供了準確且快速的天線參數及場型量測方法。主要分為量測及數據處理兩個程序，亦可幫助使用者快速地分析和同時處理比較多個測試資料結果。	天線測試。	工研院環境建構總計畫
21	108	無線網路模組用天線設計報告	本報告中的天線以印刷電路板(PCB)進行設計與製作，各天線的特性亦經過模擬或分析進行特性驗證。	雙頻無線網卡的相關產品。	自動駕駛感知次系統攻堅計畫
22	108	高調變效率與低光損耗之相位調制器	矽光子調變器設計，改變不同結構之相位調制器，用於 Mach Zehnder 與環形調變器。	矽光子光通訊(半導體代工、封裝)	雲端/數據中心之光互聯計畫

件次	產出年度	中文名稱	技術特色	可應用範圍	計畫名稱
		優化設計應用於矽光子電光調變器		測試、光通訊組裝等)。	
23	108	50 GHz Mach Zehnder Modulator 之傳輸線設計	50GHz 以上之高速 Mach Zehnder 調變器對應匹配之傳輸線設計	矽光子光通訊(半導體代工、封裝測試、光通訊組裝等)。	雲端/數據中心之光互聯計畫
24	108	矽光子被動元件自動化量測系統技術報告	光電整合量測系統自動化操作介面與控制程式。	光通訊、光儲存、矽光晶片測試。	雲端/數據中心之光互聯計畫
25	107	矽光晶片光學封裝技術開發	雷射晶粒、透鏡、反射鏡與基座平台整合技術與參數開發。	矽光子光通訊(半導體代工、封裝測試、光通訊組裝等)。	雲端/數據中心之光互聯計畫
26	107	200G-FR4 光通訊產品封裝技術開發	200G-FR4 光收發器之零組件與 PCB 搭配設計。	光通訊、光儲存、矽光晶片測試。	所內應用研究計畫

## 二、專利授權標的 (117 案 173 件)

組合名稱	案次	件次	件編號	中文專利名稱	狀態	國家	申請案號/專利證號	委辦單位	專利種類	專利起期	專利迄期	契約運用
(一) 透明顯示系統平台技術 (21 案 27 件)	1	1	P61020039US	觸控面板及其感測方法	獲證	美國	10,168,732	經濟部技術處	發明	2019 0101	2036 0309	共有
	2	2	P61030032CN	觸控感應方法、觸控顯示裝置及可攜式電子裝置	獲證	中國	ZL201510595998.9	經濟部技術處	發明	2018 1123	2035 0917	共有
	3	3	P61040004CN	感應裝置	獲證	中國	ZL201511003464.9	經濟部技術處	發明	2019 0426	2035 1227	共有
	4	4	P61040021US	可彎摺機構及可彎摺顯示裝置	獲證	美國	10,168,733	經濟部技術處	發明	2019 0101	2036 0509	共有
	5	5	P61040036CN	保護結構以及電子裝置	獲證	中國	ZL201610939275.0	經濟部技術處	發明	2019 0219	2036 1031	
	6	6	P61050037TW	透明顯示裝置、使用其之控制方法以及其之控制器	獲證	台灣	I659334	經濟部技術處	發明	2019 0511	2037 1108	共有
	7	7	P61060001US	畫素結構以及顯示面板	公開	美國	15/691,755	經濟部技術處	發明			共有
	8	8	P61060002TW	顯示面板以及感測顯示面板	獲證	台灣	I649598	經濟部技術處	發明	2019 0201	2037 0808	共有

組合名稱	案次	件次	件編號	中文專利名稱	狀態	國家	申請案號/ 專利證號	委辦 單位	專利 種類	專利 起期	專利 迄期	契約運用	
(一) 透明顯示系統 平台技術 (21案 27件)	9	9	P61060011TW	發光元件及其透明電極	獲證	台灣	I660533	經濟部 技術處	發明	2019 0521	2037 0914	共有、非專 屬授權中	
		10	P61060011CN		公開	中國	2017110126 61.6	經濟部 技術處	發明				
	10	11	P61060017TW	觸控顯示面板	獲證	台灣	I656466	經濟部 技術處	發明	2019 0411	2038 0325	共有	
	11	12	P61060020TW	發光裝置	獲證	台灣	I649737	經濟部 技術處	發明	2019 0201	2037 1017	共有	
	12	13	P61060021TW	光電元件封裝體	暫准	台灣	106145934	經濟部 技術處	發明				共有
		14	P61060021US		獲證	美國	10,276,761	經濟部 技術處	發明	2019 0430	2038 0411	共有	
	13	15	P61060023CN	保護結構以及電子裝置	公開	中國	2017113318 18.1	經濟部 技術處	發明			共有	
	14	16	P61060027TW	薄膜電晶體及其製造方法	獲證	台灣	I648844	經濟部 技術處	發明	2019 0121	2037 1105	共有、非專 屬授權中	
	14	17	P61060027CN	薄膜晶體管及其製造方法	公開	中國	2017113966 21.6	經濟部 技術處	發明				
	15	18	P61060028TW	透明顯示裝置及使用其之控制 方法	暫准	台灣	106143783	經濟部 技術處	發明			共有	
		19	P61060028CN	透明顯示裝置及其控制方法	公開	中國	2018103922 16.5	經濟部 技術處	發明			共有	
	16	20	P61060029CN	影像辨識系統及其信息顯示方 法	公開	中國	2018101595 67.1	經濟部 技術處	發明			共有	
		21	P61060029US	影像辨識系統及其資訊顯示方 法	公開	美國	16/104,096	經濟部 技術處	發明			共有	
	17	22	P61060031TW	耐衝擊減震結構及電子裝置	公開	台灣	106146308	經濟部 技術處	發明			共有	
		23	P61060031CN	耐衝擊減震結構及電子裝置	公開	中國	2017114652 16.5	經濟部 技術處	發明			共有	
	18	24	P61060038TW	雙介質顯示面板之驅動方法及 應用其之電子裝置及顯示系統	獲證	台灣	I660634	經濟部 技術處	發明	2019 0521	2037 1225	共有	
	19	25	P61060043CN	交互式顯示系統及交互式顯示 控制方法	公開	中國	2018100914 77.3	經濟部 技術處	發明			共有	
	20	26	P51060023TW	基板傳輸單元與鍍膜設備	獲證	台灣	I642808	經濟部 技術處	發明	2018 1201	2037 1113		
	21	27	P51060029TW	蒸鍍裝置及其校正方法	暫准	台灣	106137312	經濟部 技術處	發明				



組合名稱	案次	件次	件編號	中文專利名稱	狀態	國家	申請案號/ 專利證號	委辦 單位	專利 種類	專利 起期	專利 迄期	契約運用
(二) 面板級 扇外型 封裝 技術 (17案 25件)	22	28	P61030015CN	軟性電子裝置	獲證	中國	ZL2014108 34333.4	經濟部 技術處	發明	2019 0412	2034 1228	共有
	23	29	P61030026TW	可撓性環境敏感電子元件封裝 體	獲證	台灣	I656672	經濟部 技術處	發明	2019 0411	2035 0514	共有
		30	P61030026CN	可撓性環境敏感電子元件封裝	獲證	中國	ZL2015104 89470.3	經濟部 技術處	發明	2018 0831	2035 0810	共有
	24	31	P61040003US	可撓式電子模組及其製造方法	獲證	美國	10,098,225	經濟部 技術處	發明	2018 1009	2036 0525	共有
	25	32	P61040011US	取下貼合裝置及應用此裝置之 取下方法與貼合方法	獲證	美國	10,173,407	經濟部 技術處	發明	2019 0108	2036 0420	共有
	26	33	P61040024US	軟性電子裝置及其製造方法	獲證	美國	10,165,688	經濟部 技術處	發明	2018 1225	2036 0424	共有
	27	34	P61040032CN	軟性電子裝置與軟性電子裝置 製作工藝方法	獲證	中國	ZL2016107 07191.4	經濟部 技術處	發明	2019 0430	2036 0822	
	28	35	P61050006TW	可撓性電子裝置	獲證	台灣	I651021	經濟部 技術處	發明	2019 0211	2036 1127	
	29	36	P61050011US	晶片封裝體以及晶片封裝方法	獲證	美國	10,090,272	經濟部 技術處	發明	2018 1002	2037 0120	
	30	37	P61050025TW	封裝結構及其製作方法	獲證	台灣	I648830	經濟部 技術處	發明	2019 0121	2037 0501	
	31	38	P61060015CN	半導體封裝結構	公開	中國	2017112234 74.2	經濟部 技術處	發明			共有、非專 屬授權中
		39	P61060015US		公開	美國	15/849,593	經濟部 技術處	發明			
	32	40	P61060024TW	晶片接合裝置、晶片接合的方 法以及晶片封裝結構	暫准	台灣	106137307	經濟部 技術處	發明			共有
		41	P61060024CN	芯片接合裝置、芯片接合的方 法以及芯片封裝結構	公開	中國	2017112693 85.1	經濟部 技術處	發明			共有
	33	42	P61060025TW	半導體封裝重佈線層結構	公開	台灣	106138776	經濟部 技術處	發明			共有
		43	P61060025CN		公開	中國	2017113997 70.8	經濟部 技術處	發明			共有
		44	P61060025US		獲證	美國	10,249,567	經濟部 技術處	發明	2019 0402	2037 1224	共有
34	45	P61060026TW	封裝結構及其形成方法	獲證	台灣	I660473	經濟部 技術處	發明	2019 0521	2037 1225	共有	
35	46	P61060030CN	整平裝置	公開	中國	2017112234 71.9	經濟部 技術處	發明			共有	



組合名稱	案次	件次	件編號	中文專利名稱	狀態	國家	申請案號/ 專利證號	委辦 單位	專利 種類	專利 起期	專利 迄期	契約運用
(二) 面板級 扇出型 封裝 技術 (17 案 25 件)	36	47	P61060034TW	分離裝置及分離方法	暫准	台灣	106146205	經濟部 技術處	發明			共有
		48	P61060034CN		公開	中國	2017114685 67.1	經濟部 技術處	發明			共有
	37	49	P61060035TW	晶片封裝結構	獲證	台灣	I661517	經濟部 技術處	發明	2019 0601	2037 1203	共有、非專 屬授權中
		50	P61060035CN	芯片封裝結構	公開	中國	2017114319 09.2	經濟部 技術處	發明			
	38	51	P61060046TW	可撓性晶片封裝	公開	台灣	106145487	經濟部 技術處	發明			共有
		52	P61060046CN	可撓性芯片封裝	公開	中國	2017114192 64.0	經濟部 技術處	發明			共有
(三) OLED 照明 (7 案 7 件)	39	53	P51040040CN	發光組件	獲證	中國	ZL2016102 78151.2	經濟部 技術處	發明	2018 0921	2036 0428	
	40	54	P51040060US	發光裝置的驅動系統及驅動方法	獲證	美國	10,117,305	經濟部 技術處	發明	2018 1030	2036 0908	曾非專屬 授權
	41	55	P51050068US	發光元件與發光元件的製造方法	獲證	美國	10,249,803	經濟部 技術處	發明	2019 0402	2037 0314	
	42	56	P51050077US	利用激發複合體製作高效率及低效率滾降白光照明元件	獲證	美國	10,276,801	經濟部 技術處	發明	2019 0430	2037 0719	
	43	57	P51050083TW	有機發光元件	獲證	台灣	I660535	經濟部 技術處	發明	2019 0521	2037 0321	
	44	58	P51050093TW	有機光電元件及有機光電模組	獲證	台灣	I641168	經濟部 技術處	發明	2018 1111	2037 0523	
	45	59	P51060012TW	薄膜以及有機發光元件的製造方法	獲證	台灣	I650618	經濟部 技術處	發明	2019 0211	2037 1002	
(四) 功率裝 置/模組 (3 案 5 件)	46	60	P51050024TWC1	插拔式功率模組及次系統	獲證	台灣	I647995	經濟部 技術處	發明	2019 0111	2037 0525	
	47	61	P51050064US	智能型功率模組診斷系統及其方法	獲證	美國	10,288,696	經濟部 技術處	發明	2019 0514	2037 0707	
	48	62	P51060042TW	晶片封裝	獲證	台灣	I660471	經濟部 技術處	發明	2019 0521	2037 1226	非專屬 授權中
		63	P51060042CN	芯片封裝	公開	中國	2018104470 22.0	經濟部 技術處	發明			
		64	P51060042US	晶片封裝	公開	美國	15/976,886	經濟部 技術處	發明			
	49	65	P51010010TW	嵌埋有中介層之封裝基板及其製法	獲證	台灣	I492680	工研院	發明	2015 0711	2031 0804	共有

組合名稱	案次	件次	件編號	中文專利名稱	狀態	國家	申請案號/ 專利證號	委辦 單位	專利 種類	專利 起期	專利 迄期	契約運用
(五) 系統級 構裝技術(SiP) (4案 13件)	50	66	P51010010CN	嵌埋有中介層之封裝基板及其製法	獲證	中國	ZL2012102 66187.0	工研院	發明	2015 1028	2032 0729	共有
		67	P51010010US		獲證	美國	9,385,056	工研院	發明	2016 0705	2032 1025	共有
		68	P51010010JP		獲證	日本	5396508	工研院	發明	2013 1025	2032 0515	共有
		69	P51010010EP		公開	歐盟	EP1217942 4.2	工研院	發明			共有
	51	70	P51010011TW	封裝基板及其製法	獲證	台灣	I483365	工研院	發明	2015 0501	2032 0925	共有
		71	P51010011CN		獲證	中國	ZL2013101 46107.2	工研院	發明	2019 0205	2033 0423	共有
		72	P51010011USD1	封裝基板及其製法	獲證	美國	10,068,847	工研院	發明	2018 0904	2033 0812	共有
		73	P51010011USD2		公開	美國	16/036,946	工研院	發明			共有
	52	74	P51010012TW	封裝基板及其製法	獲證	台灣	I499023	工研院	發明	2015 0901	2032 1010	共有
		75	P51010012CN	封裝基板及其製作方法	獲證	中國	ZL2013101 46277.0	工研院	發明	2017 0118	2033 0423	共有
		76	P51010012US	封裝基板及其製法	獲證	美國	9,485,874	工研院	發明	2016 1101	2033 0825	共有
	52	77	P51020039CN	薄化集成電路裝置與其製作流程	獲證	中國	ZL2014106 27580.7	經濟部 技術處	發明	2018 1130	2034 1106	
	(六) 半導體 光源 (12案 15件)	53	78	P51010099CNC1	光源裝置及顯示裝置	公開	中國	2018106726 45.8	經濟部 技術處	發明		
79			P51010099CND1	光源裝置及照明裝置	獲證	中國	ZL2016103 39601.4	經濟部 技術處	發明	2018 1123	2033 1226	
54		80	P51040028CN	發光裝置的驅動方法與發光裝置	獲證	中國	ZL2015109 68320.0	經濟部 技術處	發明	2018 1019	2035 1221	
55		81	P51040050US	紫外光發光二極體的封裝結構	獲證	美國	10,134,963	經濟部 技術處	發明	2018 1120	2036 1010	
56		82	P51060033TWC1	流體殺菌裝置	獲證	台灣	M576883	經濟部 技術處	新型	2019 0421	2028 0821	
57		83	P51060038TW	照明控制系統及照明控制方法	獲證	台灣	I647976	經濟部 能源局	發明	2019 0111	2037 1129	
58		84	P51060040TW	照明系統及其控制方法	公開	台灣	106143693	工研院	發明			非專屬

組合名稱	案次	件次	件編號	中文專利名稱	狀態	國家	申請案號/ 專利證號	委辦 單位	專利 種類	專利 起期	專利 迄期	契約運用
(六) 半導體 光源 (12案 15件)		85	P51060040US	照明系統及其控制方法	公開	美國	15/936,472	工研院	發明			授權中
	59	86	P51060041US	燈具控制方法、燈具控制裝置 及電腦程式產品	獲證	美國	10,271,410	經濟部 技術處	發明	2019 0423	2038 0507	
	60	87	P51070038EP	光源裝置及照明裝置	公開	歐盟	EP1817970 3.6	工研院	發明			
	61	106	P51060032TW	發光二極體封裝	獲證	台灣	I661585	經濟部 技術處	發明	2019 0601	2037 1220	
	61	107	P51060032US	發光二極體封裝	獲證	美國	10,134,709	經濟部 技術處	發明	2018 1120	2037 1220	
	62	88	P51030026CN	增強型氮化鎵晶體管器件	獲證	中國	ZL2014106 08510.7	經濟部 技術處	發明	2018 0914	2034 1030	
	63	89	P51060007TW	歐姆接觸結構及具有此歐姆接 觸結構之高電子移動率電晶體	暫准	台灣	106117919	經濟部 技術處	發明			
	64	90	P51030001USC1	無線充電系統	獲證	美國	10,211,664	工研院	發明	2019 0219	2030 1102	
(七) 光電 半導體 技術 (4案 6件)		91	P51060002TWC1	轉移支撐件及轉移模組	獲證	台灣	I655703	經濟部 技術處	發明	2019 0401	2038 0329	
	65	92	P51060002CNC1		公開	中國	2018104876 71.3	經濟部 技術處	發明			
		93	P51060002US		公開	美國	15/847,950	經濟部 技術處	發明			
	66	94	P51050030CN	光學元件	獲證	中國	ZL2016106 14952.1	經濟部 技術處	發明	2019 0405	2036 0728	
	67	95	P51070025TW	光通訊模組	獲證	台灣	M573840	經濟部 技術處	新型	2019 0201	2028 1001	
	68	96	P51050018US	光載微波網路節點、無線電存 取點及其光載微波通訊系統	獲證	美國	10,284,295	經濟部 技術處	發明	2019 0507	2037 0113	
	(八) 記憶體 (6案 9件)	69	97	P51030032TW	電阻式記憶體系統、其驅動電 路及其阻抗設置方法	獲證	台灣	I646531	經濟部 技術處	發明	2019 0101	2034 1204
		98	P51030032CN	獲證		中國	ZL2015100 46032.X	經濟部 技術處	發明	2019 0426	2035 0128	
70		99	P51030056TW	電阻式隨機存取記憶體與其控 制方法	獲證	台灣	I649748	經濟部 技術處	發明	2019 0201	2035 0113	
		100	P51030056TWD1	電阻式隨機存取記憶體控制方 法	公開	台灣	107141761	經濟部 技術處	發明			
71		101	P51040013TW	驅動電源產生電路以及驅動電 源的產生方法	獲證	台灣	I647975	經濟部 技術處	發明	2019 0111	2035 0902	

組合名稱	案次	件次	件編號	中文專利名稱	狀態	國家	申請案號/ 專利證號	委辦 單位	專利 種類	專利 起期	專利 迄期	契約運用
(八) 記憶體 (6案 9件)	72	102	P51050013US	垂直磁化自旋軌道磁性元件	獲證	美國	10,193,059	經濟部 技術處	發明	2019 0129	2036 1121	
	73	103	P51050072US	物理性不可複製功能電路、磁阻式可變電阻裝置與物理性不可複製功能電路之控制方法	獲證	美國	10,090,033	經濟部 技術處	發明	2018 1002	2037 0724	
	74	104	P51060027CN	自旋軌道磁性記憶體及其製造方法	公開	中國	2018103446 93.4	經濟部 技術處	發明			
	74	105	P51060027US	自旋軌道磁性記憶體及其製造方法	公開	美國	16/055,000	經濟部 技術處	發明			
	75	108	P51020019CN	半導體結構及其製造方法	獲證	中國	ZL2013105 24556.6	經濟部 技術處	發明	2019 0308	2033 1029	非專屬 授權中
(九) 感測器 (7案 10件)	76	109	P51040051US	感測元件及其製造方法	獲證	美國	10,156,535	經濟部 技術處	發明	2018 1218	2036 0622	
	77	110	P51050054TW	感測器介面電路和感測器輸出調整方法	獲證	台灣	I649972	經濟部 技術處	發明	2019 0201	2037 0911	
		111	P51050054US		獲證	美國	10,101,175	經濟部 技術處	發明	2018 1016	2037 0525	
	78	112	P51060020TW	感測器的讀取電路及其讀取方法	獲證	台灣	I644107	經濟部 技術處	發明	2018 1211	2037 1122	
	79	113	P51060016TW	光學式微粒子偵測器	獲證	台灣	I658264	經濟部 技術處	發明	2019 0501	2037 0906	
		114	P51060016CN		公開	中國	2017113155 91.1	經濟部 技術處	發明			
		115	P51060016US		公開	美國	15//842,889	經濟部 技術處	發明			
80	116	P51040017US	微粒子偵測器及篩選元件之製造方法	獲證	美國	10,121,673	經濟部 技術處	發明	2018 1106	2036 0424		
81	117	P51070069TW	影像感測器及其製造方法	獲證	台灣	I660493	經濟部 技術處	發明	2019 0521	2038 1205		
(十) 電路 載板 (10案 23件)	82	118	P03920014US	具內藏電容之基板結構	獲證	美國	7,064,427	經濟部 技術處	發明	2006 0620	2024 0825	
	83	119	P51000118TW	固態電解電容基板模組及包括該固態電解電容基板模組的電路板	獲證	台灣	I483352	經濟部 技術處	發明	2015 0501	2032 0311	
		120	P51000118CN	固態電解電容基板模塊及包括其的電路板	獲證	中國	ZL2012101 39386.5	經濟部 技術處	發明	2016 1207	2032 0506	

組合名稱	案次	件次	件編號	中文專利名稱	狀態	國家	申請案號/ 專利證號	委辦 單位	專利 種類	專利 起期	專利 迄期	契約運用
(十) 電路 載板 (10 案 23 件)		121	P51000118US	固態電解電容基板模組及包括該固態電解電容基板模組的電路板	獲證	美國	9,030,808	經濟部 技術處	發明	2015 0512	2033 0611	
	84	122	P51000130TW	電感結構	獲證	台灣	I442422	經濟部 技術處	發明	2014 0621	2032 0118	
		123	P51000130CN		獲證	中國	ZL2012101 68092.5	經濟部 技術處	發明	2016 0413	2032 0524	
		124	P51000130US		獲證	美國	8,686,821	經濟部 技術處	發明	2014 0401	2032 0618	
	85	125	P51010096TW	螺旋電感結構	獲證	台灣	I462126	經濟部 技術處	發明	2014 1121	2032 1227	
	86	126	P51010098TW	內藏電容模組	獲證	台灣	I510152	經濟部 技術處	發明	2015 1121	2033 0709	
	87	127	P51950016TW	互補鏡像式內藏平面電阻架構	獲證	台灣	I370708	工研院	發明	2012 0811	2026 1019	
		128	P51950016US		獲證	美國	8,035,036	工研院	發明	2011 1011	2029 0418	
	88	129	P51960146TW	記憶體電容的電極結構及其製造方法	獲證	台灣	I482209	經濟部 技術處	發明	2015 0421	2028 0304	
		130	P51960146CN	存儲器電容的電極結構以及存儲器電容結構的製造方法	獲證	中國	ZL2008100 85490.4	經濟部 技術處	發明	2011 0713	2028 0318	
		131	P51960146US	記憶體電容的電極結構及其製造方法	獲證	美國	7,999,350	經濟部 技術處	發明	2011 0816	2029 0302	
	89	132	P51970101TW	電容結構	獲證	台灣	I467610	經濟部 技術處	發明	2015 0101	2029 0722	
		133	P51970101CN		獲證	中國	ZL2009101 73551.7	經濟部 技術處	發明	2013 0102	2029 0914	
		134	P51970101US		獲證	美國	8,488,299	經濟部 技術處	發明	2013 0716	2031 0525	
	90	135	P51990101CN	立體式電感	獲證	中國	ZL2010106 21758.9	經濟部 技術處	發明	2014 0122	2030 1223	
		136	P51990101US		獲證	美國	8,339,233	經濟部 技術處	發明	2012 1225	2031 0517	
	91	137	P51990110TW	內藏電容基板模組	獲證	台灣	I405322	經濟部 技術處	發明	2013 0811	2030 1228	
		138	P51990110CN		獲證	中國	ZL2010106 23839.2	經濟部 技術處	發明	2015 0107	2030 1230	



組合名稱	案次	件次	件編號	中文專利名稱	狀態	國家	申請案號/ 專利證號	委辦 單位	專利 種類	專利 起期	專利 迄期	契約運用
		139	P51990110US	內藏電容基板模組	獲證	美國	8,941,015	經濟部 技術處	發明	2015 0127	2033 0122	
		140	P51990110USC1		獲證	美國	9,013,893	經濟部 技術處	發明	2015 0421	2032 0205	
(十一) 寬能隙 元件 (4案 4件)	92	141	P51050067TW	半導體結構及其製造方法	獲證	台灣	I650867	經濟部 技術處	發明	2019 0211	2037 0711	
	93	142	P51060009US	氮化鎵電晶體元件之結構及其 製造方法	獲證	美國	10,170,580	經濟部 技術處	發明	2019 0101	2037 1022	
	94	143	P51060010TW	三族氮化物半導體結構	獲證	台灣	I649873	經濟部 技術處	發明	2019 0201	2037 0725	
	95	144	P51060013CN	磊晶晶圓	公開	中國	2017108741 42.4	經濟部 技術處	發明			
(十二) 影像 技術 (6案 8件)	96	145	P51030012CN	對象識別方法與裝置	獲證	中國	ZL2014108 08883.9	經濟部 技術處	發明	2019 0510	2034 1222	
	97	146	P51040035US	測量系統	獲證	美國	10,210,625	經濟部 技術處	發明	2019 0219	2036 0619	非專屬 授權中
	98	147	P51050060TW	多孔洞檢測系統、裝置及方法	獲證	台灣	I650549	經濟部 技術處	發明	2019 0211	2036 1218	
	99	148	P51050037US	場景掃描方法及系統	獲證	美國	10,281,265	經濟部 技術處	發明	2019 0507	2037 0313	
	100	149	P51050051US	影像掃描系統及其方法	獲證	美國	10,262,242	經濟部 技術處	發明	2019 0416	2037 1123	
	101	150	P51060022TW	三維模型建構方法及其系統	獲證	台灣	I651687	經濟部 技術處	發明	2019 0221	2037 1123	
		151	P51060022CN		公開	中國	2017113438 58.8	經濟部 技術處	發明			
152		P51060022US	公開		美國	15/855,266	經濟部 技術處	發明				
(十三) 軟體 (6案 11件)	102	153	P51960100US	專利分析平台	獲證	美國	D579,456	經濟部 技術處	設計	2008 1028	2022 1027	共有
		154	P51960100USC1		獲證	美國	D598,923	經濟部 技術處	設計	2009 0825	2023 0824	共有
	103	155	P51960101TWC1	技術資料分析的系統與方法以 及專利分析的系統	獲證	台灣	I410814	經濟部 技術處	發明	2013 1001	2028 1019	共有
		156	P51960101CN	技術數據分析的系統與方法	獲證	中國	ZL2007101 93643.2	經濟部 技術處	發明	2016 0928	2027 1122	共有
104	157	P51970006TWC1	技術文獻擷取系統與方法及專 利文獻擷取系統	獲證	台灣	I409648	工研院	發明	2013 0921	2029 0305	共有	

組合名稱	案次	件次	件編號	中文專利名稱	狀態	國家	申請案號/ 專利證號	委辦 單位	專利 種類	專利 起期	專利 迄期	契約運用	
(十三) 軟體 (6案 11件)		158	P51970006TWD1	技術文獻之閱讀系統與產生專利文獻之專利資訊的方法以及電腦可讀取儲存媒體	獲證	台灣	I595369	工研院	發明	2017 0811	2029 0305	共有	
		159	P51970006US	技術文獻之擷取與閱讀暨評論的系統和方法	獲證	美國	8,373,880	工研院	發明	2013 0212	2031 1023	共有	
		160	P51970006USD1	技術文獻之閱讀系統與產生專利文獻之專利資訊的方法以及電腦可讀取儲存媒體	獲證	美國	8,599,449	工研院	發明	2013 1203	2028 1229	共有	
	105	161	P51970050TWC1	智慧型專利監控及警示系統與方法	獲證	台灣	I476689	經濟部 技術處	發明	2015 0311	2029 0823	共有	
	106	162	P51060017TW	監管系統	公開	台灣	106138182	經濟部 技術處	發明				
	107	163	P51060046TW	動態智能排程方法及裝置	獲證	台灣	I650714	經濟部 技術處	發明	2019 0211	2038 0118	非專屬 授權中	
(十四) 其他 (10案 10件)	108	164	P51030015CN	三維對稱型垂直變壓器	獲證	中國	ZL2014105 30860.6	經濟部 技術處	發明	2018 1123	2034 1009		
	109	165	P51030028TW	發光裝置及其製造方法	獲證	台灣	I651874	經濟部 技術處	發明	2019 0221	2034 1130		
	110	166	P51030033CN	整合式毫米波芯片封裝結構	獲證	中國	ZL2014107 78230.0	經濟部 技術處	發明	2019 0125	2034 1214		
	111	167	P51030039CN	天線整合式封裝結構及其製造方法	獲證	中國	ZL2014107 76762.0	經濟部 技術處	發明	2019 0104	2034 1214		
	112	168	P51040005TW	貼合結構、其製造方法及晶粒結構	獲證	台灣	I645479	經濟部 技術處	發明	2018 1221	2035 0512		
	113	169	P51050050TW	晶片封裝以及複合型系統板	獲證	台灣	I657552	經濟部 技術處	發明	2019 0421	2037 0417		
	114	170	P51060043TW	晶片封裝模組及包含其之電路板結構	獲證	台灣	I658547	經濟部 技術處	發明	2019 0501	2038 0131		
	115	171	P51050075US	電磁波傳輸板及差動電磁波傳輸板	獲證	美國	10,276,908	經濟部 技術處	發明	2019 0430	2037 0411		
	116	172	P51050066US	軌道式 OLED 燈具組合	獲證	美國	10,197,255	工研院	發明	2019 0205	2037 0404		
	117	173	P51060024TW	輔具的設計方法及設計輔具的電子系統	獲證	台灣	I648646	經濟部 技術處	發明	2019 0121	2038 0208		

備註：本公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之延續案、分割案、EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利、PCT 同一案所申請之各國專利。